

環境配慮型プリント配線板製造プロセス

Environmentally-Friendly PWB Process

EF-PWB PROCESS

- 既存プロセスと比較し、廃液発生工程を削減

Reduce wastewater generating step from conventional processes

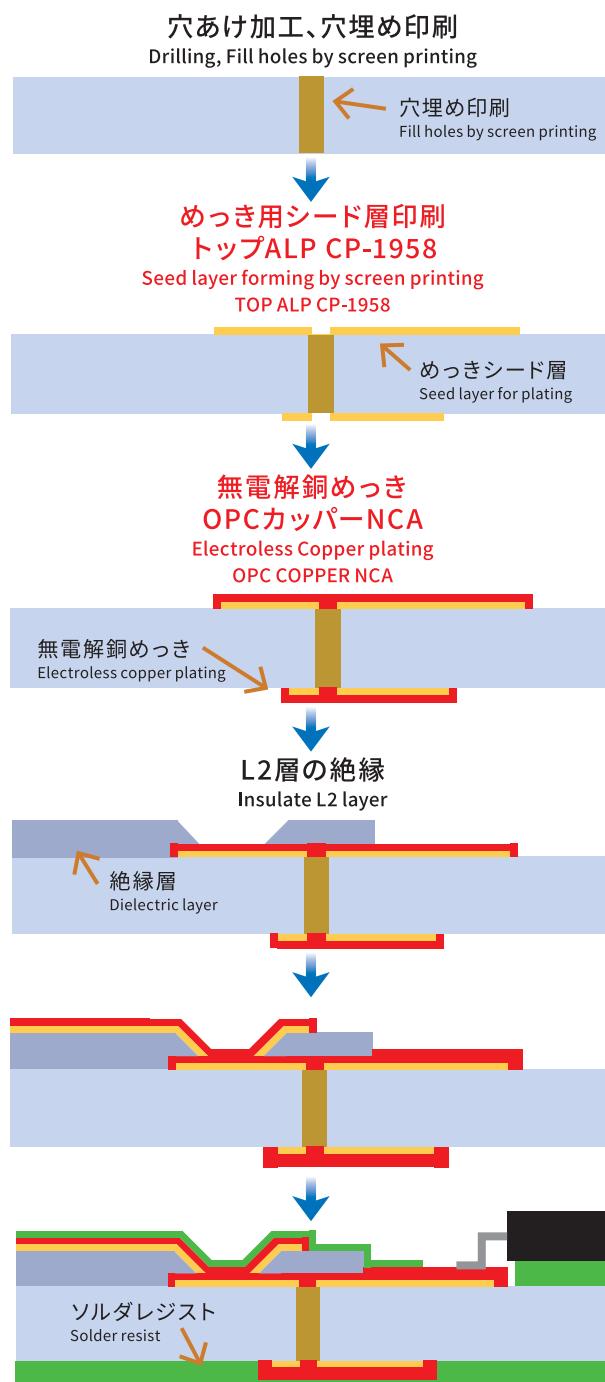
- スクリーン印刷と無電解銅めっきで回路形成

Can form pattern by screen printing and electroless copper plating

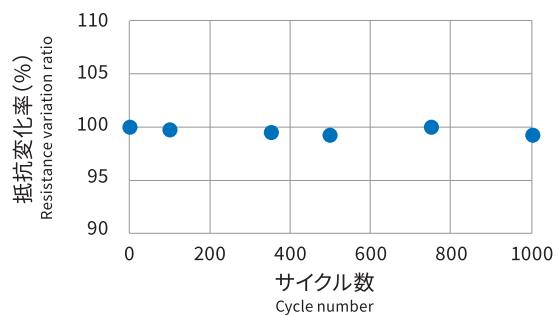
- 多層化対応

Can use for multi-layer PWBS

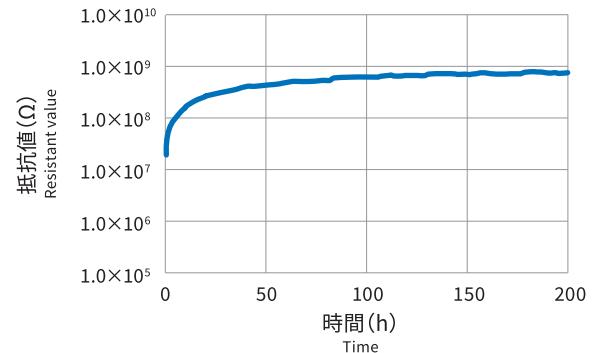
製造プロセス(多層化例) Process (Example for Multilayered)



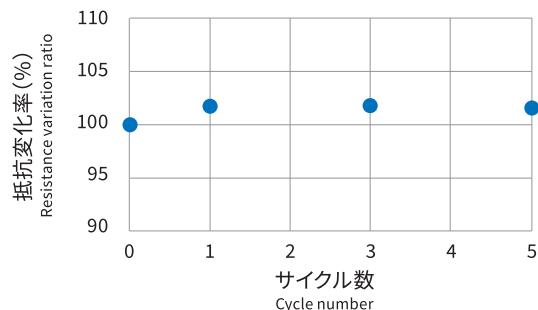
高い信頼性 High reliability



ヒートサイクル試験における抵抗値変化 (-65°C⇒125°C)
Resistance variation in thermo-cycle test



HAST試験における抵抗値変化 (120°C, 85%RH)
Resistance value variation by high accelerated stress test



はんだリフロー試験における抵抗値変化 (250°C)
Resistance value variation by solder reflow test